

Der neue Maßstab für kleine Aperturen

Basierend auf dem bewährten LPKF StencilLaser G 6080 Systemkonzept, bietet der LPKF MicroCut 6080 einzigartige Vorteile für Anwender, die auf extrem kleine Schablonenöffnungen und entsprechende Druckergebnisse Wert legen.

Modernste Positionierungs- und Schneidtechnologie, die speziell auf die Anforderungen kleiner Öffnungen abgestimmt ist, ermöglicht das Schneiden exakter Kleinstöffnungen. Diese sind mit einer Größe von nur 18 µm auf der Lasereintrittsseite und 10 µm auf der Ausgangsseite (in 30-µm-Edelstahlfolie) eine Grundlage dafür, bestehende Prozessgrenzen zu überwinden und den steigenden Marktanforderungen gerecht zu werden. Hohe Präzision und hohe Durchsatzzahlen ergänzen diese Vorteile.

Die einfache Programmierbarkeit und umfassende Softwarefunktionen wie etwa die Parametersuche ermöglichen einen zügigen Prozessstart. Anwendungsbereiche sind beispielsweise Waferschablonen, Flux-Stencils oder Filterapplikationen.

Ansprechpartner:

Cordula Krause-Widjaja
cordula.krause-
widjaja@lpkf.com
Tel. +49 (0)5131 7095-1327
Fax +49 (0)5131 7095-90

LPKF Laser & Electronics AG

Osteriede 7
D-30827 Garbsen
www.lpkf.de

Vorstand:

Dr. Götz M. Bendele (CEO)
Christian Witt (CFO)

Aktie:

Prime Standard
ISIN 0006450000

Abdruck frei, Beleg erbeten

» [Weitere Pressemeldungen](#)

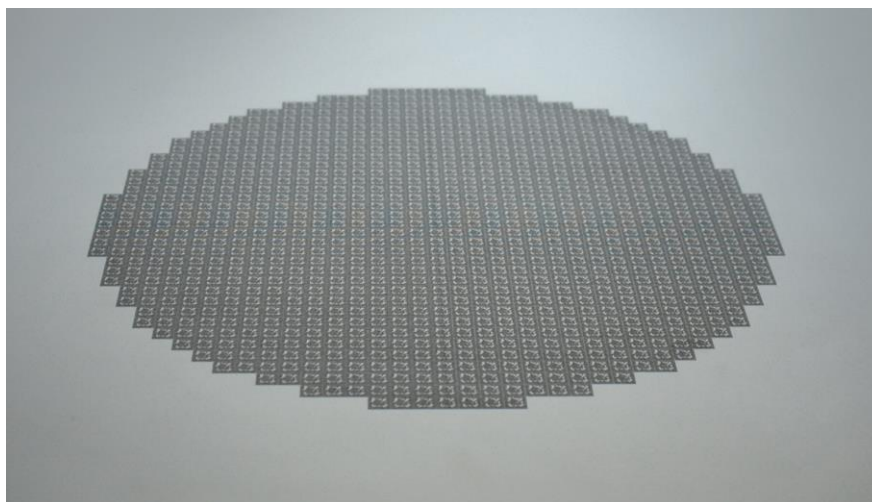


Abb.: Mit LPKF MicroCut 6080 produziert: Stencil Wafer

Über LPKF

LPKF Laser & Electronics AG produziert Maschinen und Lasersysteme, die in der Elektronikfertigung, der Medizintechnik, der Automobilindustrie und bei der Herstellung von Solarzellen zum Einsatz kommen. Rund 20 Prozent der Mitarbeiter sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt.